



# 台灣恩智浦半導體 暑期實習計畫

## 實習領域：

- 半導體封裝製程/ 測試技術工程
- 生產流程改善/ 產品品質改善

**實習地點：**高雄（楠梓加工區經四路7號）

## 實習期間：

- 2018年7月2日至2018年8月31日（共9周）
- 每位實習生依所學專長分派專案，並由專人輔導
- 實習期間由公司給付薪資並提供勞保及團體保險
- 實習期末發表後，將獲頒恩智浦半導體實習證明
- 參與實習者應遵守公司規定，並自理住宿及交通

## 申請資格：

- 大四至碩一或碩二之理工相關科系在學生
- 具教授推薦函及碩士生優先晉用

## 申請方式：

請備妥下列資料，於**5月12日前**寄至恩智浦人資部伍小姐  
[helen.wu@nxp.com](mailto:helen.wu@nxp.com)，信件標題請註明 申請NXP暑期實習

1. 中英文履歷表/自傳
2. 學生證或已錄取碩班之證明及在校成績單影本
3. 若有與所學相關之專題或論文簡介亦可附上

**暑期實習相關資訊請洽：07-3612511 #8222人資部 伍小姐**